

## 关于召开“2021年中国覆铜板行业高层论坛 暨 CCLA 成立三十周年庆典”的通知

中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）定于2021年7月22日至25日在青海省西宁市召开“2021年中国覆铜板行业高层论坛”会议，并同期举办“CCLA成立三十周年庆典”。

2021年，是“十四·五”规划的开局之年，我国经济建设进入新发展阶段，面对新机遇、新挑战，我国覆铜板产业如何深入推进产品转型升级，满足市场新需求。在这种形势下，召开本届高层论坛，具有非凡的现实意义。

本届论坛的主题为“**构强供应链 创新促发展**”。将邀请上级主管部门领导、覆铜板行业及上下游行业的国内外著名专家、企业家围绕大会主题，与参会代表共同交流、探讨：我国覆铜板行业如何应对我国覆铜板原材料供需链的格局改变？如何应对我国覆铜板市场结构的重大变化？我国覆铜板企业如何在大变局下抵御风险、产品升级、持续创新发展？

2021年是中国共产党成立100周年华诞，也是CCLA的而立之年。三十年经历巨变，旧貌换新颜；三十年奋发图强，敢为天下先；三十年非凡历程，春华秋实；三十年，中国已成为全球覆铜板制造和消费的第一大国。值此之际，CCLA理事会决定，举办主题为“**征程三十年 共创新辉煌**”的庆典活动，回忆总结，表彰先进，继往开来，谋划新征程。

庆典活动将邀请上级主管部门领导、CCLA 历任理事长秘书长、兄弟协会领导、CCLA 全体会员单位及海内外业界同仁出席庆典活动。

“2021 年中国覆铜板行业高层论坛”由 CCLA 主办，诺德投资股份有限公司承办。

热忱欢迎各企业派遣高层领导及相关人员，参加“2021 年中国覆铜板行业高层论坛暨 CCLA 成立 30 周年庆典”。

**参会代表须接种新冠疫苗，遵守大会举办地政府的防疫相关规定。**

本届大会有关事项通知如下：

一. **主办单位：**中国电子材料行业协会覆铜板材料分会（CCLA）

二. **承办单位：**诺德投资股份有限公司

三. **赞助单位：（征集中）**

诺德投资股份有限公司

南亚新材料科技股份有限公司

山东圣泉新材料股份有限公司

山东金宝电子股份有限公司

广东超华科技股份有限公司

河南光远新材料股份有限公司

广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂

华烁科技股份有限公司

广东同宇新材料有限公司

陕西宝昱科技工业有限公司

九江福莱克斯有限公司

苏州锦艺新材料科技有限公司

浙江华正新材料股份有限公司

联茂（无锡）电子科技有限公司

广东生益科技股份有限公司

山东金鼎电子材料有限公司

威迪机电科技有限公司

建滔积层板控股有限公司

苏州福田金属有限公司

上海彤程电子材料有限公司

浙江元集新材料有限公司

成都科宜高分子科技有限公司

苏州巨峰新材料科技有限公司

南通凯迪自动机械有限公司

广州君亮模具科技有限公司

南通图海机械有限公司

美国微觉视检测技术公司  
江苏省航宇新材料股份有限公司  
梅州市威利邦电子科技有限公司  
福建利豪电子科技股份有限公司  
濮阳市恩赢高分子材料有限公司  
上海衡封新材料科技有限公司  
江苏辉迈粉体科技有限公司  
广东硕成科技有限公司  
浙江花园新能源有限公司  
征集中 . . .

江苏东材新材料有限责任公司  
浙江双元科技股份有限公司  
江苏华伦化工有限公司  
南京宜热纵联节能科技有限公司  
珠海镇东有限公司  
无锡阿尔泰钢业有限公司  
上海良晟科技有限公司  
深圳市环宇昌电子有限公司

#### 四. 会议日期:

2021年7月22日至25日(22日全天报到,23日会议,24日参观考察,25日疏散)

#### 五. 会议地址:

西宁福茵长乐国际大酒店(西宁城东经济开发区昆仑东路56号)  
电话:0971-5228888

#### 六. 会议日程: 见附件2

#### 七. 会议费用:

费用包括:会务费、资料费、餐饮费等。会员单位代表:已交会员费单位为1500元/人;未交会员费单位、非会员单位代表为1800元/人。

参会代表可提前将会务费用汇至协会账户,如参会人员有变动,可随后退费或报到现场补交。住宿:参会代表按会议优惠价提前自行与酒店联系预定房间。标间:450元/晚/间(含双早),单间:450元/晚/间(含双早),费用自理。

预定住宿联系人:孙艳 13195776303 18597107990

### 参会代表预先付款方式:

帐户: 中国电子材料行业协会

开户银行: 工行北京香河园支行

账号: 0200 0191 0900 0125 724

注: 提前汇款请在汇款之日将开票信息同会议回执一起发给会务组, 收到汇款后即可开票邮寄, 汇款时请附言“覆铜板会议会务费”, 以便区分; 现场现金缴费的请将开票信息同会议回执一起提前发到会务组, 以便会议报到时及时开票。

### 八. 会议酒店交通指南:

**西宁火车站:** 距离酒店 10 公里, 36、28 公交车可直达酒店门口; 乘坐出租车 15 分钟内到达。

**西宁曹家堡机场:** 距离酒店 17 公里, 乘坐机场大巴 3 号线到八一路客运站, 坐 28 路公交车到东新路口下车即到; 乘坐出租车 25 分钟到达。

### 九. 其他事项:

敬请所有参会代表务必将回执在 7 月 15 日前发回秘书处。

### 十. 联系方式:

CCLA 秘书处联系方式:

联系人: 董榜旗 15667263899 18791071394 (微信)

王晓艳 13609146084 15667246308 (协会微信)

联系电话: 029-33335234

电子邮箱: ccla33335234@163.com

承办单位联系方式:

诺德投资股份有限公司

会务负责人: 黄存梅 18697185767



中国电子材料行业协会覆铜板材料分会

2021 年 5 月 30 日

附件 1

### 会议回执

单位名称				
代表姓名	职务	手机	电话	E-mail
是否在“福茵长乐国际大酒店”住宿？是（ ）/否（ ），已于（ ）月（ ）日，预订了 单人房（ ）间 双人房（ ）间。				
开票信息：名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号：				
注意	1、因房源有限，需要在“福茵长乐国际大酒店”住宿的代表，务请尽快自行与酒店联系预订房间！联系时请报覆铜板行业协会，即可享受优惠价格。酒店预定房间联系人： <b>孙艳 13195776303 18597107990</b> 2、请参会代表准确填写回执表各项信息，将回执于 7 月 15 日前发至 ccl1a33335234@163.com 或 15667246308（协会微信）			

附件 2

## 2021 年中国覆铜板行业高层论坛暨 CCLA 成立 30 周年庆典

### 会议日程（暂定）

日期	会议内容	地点	主持	
7 月 22 日	全天代表报到	酒店大堂	会务组	
7 月 23 日	<b>高层论坛：</b> 1. 中电材协覆铜板材料分会理事长张东 致开幕词 2. 诺德投资股份有限公司领导 致欢迎辞 3. 西宁市领导 致辞 4. 中国电子材料行业协会理事长潘林 致辞 5. 工业和信息化部电子信息司领导作报告《 <b>题目待定</b> 》 6. 西宁市招商推广 7. 广东省电路板行业协会秘书长 辛国胜 《 <b>2020 年 PCB 行业发展概况及未来展望</b> 》 8. 广东生益科技股份有限公司董事长 刘述峰 《 <b>上下游加强协调供应链同步发展</b> 》 9. 诺德投资股份有限公司常务副总裁 陈郁弼 《 <b>电动车厚铜铜箔应用趋势</b> 》 10. 中电材协覆铜板材料分会副秘书长 祝大同 《 <b>高频高速覆铜板发展的新趋势</b> 》 11. 中电材协副秘书长、覆铜板材料分会秘书长 雷正明 《 <b>2020 年我国覆铜板行业调查解析</b> 》	可可西里厅	张东	
	12:00~13:30	午餐（自助餐）	一楼海韵西餐厅	黄存梅
	13:30~16:30	代表参观诺德投资股份有限公司青海分公司	13:30 大堂集合	会务组
	17:30~20:30	<b>CCLA 成立 30 周年庆典：</b> 1. 中电材协覆铜板材料分会理事长张东致开幕词 2. 西宁市领导 致辞 3. 中国电子电路行业协会秘书长洪芳 致辞 4. 中国电子材料行业协会理事长潘林 致辞 5. 中电材协副秘书长、覆铜板材料分会秘书长雷正明 《 <b>CCLA 三十年工作回顾</b> 》 6. 表彰杰出贡献奖、突出贡献获得者，颁发荣誉证书 7. 聘任中电材协覆铜板材料分会高级顾问，颁发聘书	可可西里厅	特邀

7月24日	代表参观考察	会务组
7月25日	代表疏散	会务组

承办单位：诺德投资股份有限公司

联系人：黄存梅 18697185767